

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2023-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	方正证券、富达基金、广发证券、广发资管、国金证券、华商基金、华夏基金、睿远基金
会议时间	2023年3月
会议地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟 证券事务代表：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司对外宣布牵头成立临港新片区 EDA 创新联合体, 请问对公司后续业务开展有什么积极影响?</p> <p>答: 3月24日, 临港新片区创新联合体授牌仪式在临港科创大会举办。作为国产 EDA 龙头企业, 概伦电子牵头联合上下游重点企业, 包括芯片制造企业、设计企业、高校等, 产学研合作共建 EDA 创新联合体, 并以此为载体形成若干针对国内特定应用的 EDA 参考设计流程, 加快推动国内 EDA 的生态建设。</p> <p>集成电路是上海市重点发展的先导产业, 也是临港新片区承载国家战略重点布局的前沿产业。临港新片区将致力于打造成为上海集成电路产业发展的新引擎、中国集成电路产业自主创新的</p>

桥头堡、世界级集成电路产业集群的承载地。目前，新片区已集聚了集成电路产业的各类行业龙头或重点企业，覆盖芯片设计、制造、材料、装备、封测等各个领域，初步构建了集成电路全产业链体系。

EDA 创新联合体将瞄准国内特别是临港新片区的集成电路产业需求，增强国内企业在 EDA 工具开发、创新与技术上的能力，明确若干芯片领域为突破口，根据实际应用场景定制 EDA 流程和工具，加速 DTCO（芯片设计与工艺协同优化）方法学和生态落地，强化“本地设计、本地制造”的理念并提升芯片产品的竞争力，形成稳定、可持续发展的商业模式。

2. 请介绍下公司 2022 年度业绩快报。

答：2022 年度，公司持续加大研发投入，拓展产品线，EDA 软件授权、测试仪器、工程服务收入均实现较快增长。公司境外收入实现稳步增长的同时，抓住国内芯片行业快速发展的机会，与战略客户展开深度合作，实现境内收入快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 27,854.97 万元，较上年度增长 43.68%。公司营业收入持续增长，带动盈利能力提升，同时，利息收入及政府补助进一步增加，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,454.65 万元，较上年度增长 55.73%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,173.59 万元，较上年度增加 36.87%。

报告期末，公司总资产为 249,687.15 万元，较报告期初增长 6.62%；归属于母公司的所有者权益为 214,989.36 万元，较报告期初增长 1.84%。

以上财务数据未经审计，最终结果以公司 2022 年年度报告披露的数据为准。

3. 请同步一下公司 2023 年股权激励计划实施进展。

答：公司本次股权激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本次拟向激励对象授予 867.60 万股限制性股票，约占发行前公司股本总额的 2%。其中，首次授予 694.08 万股，约占公司股本总额的 1.60%，占本次授予权益总额的 80%；其余部分为预留股份，将在 2023 年第一次临时股东大会批准股权激励计划后十二个月内授出。

本次股权激励计划已履行前期相关决策程序和信息披露要求，并对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会已批准公司以 2023 年 2 月 22 日为首次授予日，按照 18.41 元/股的授予价格，向 177 名激励对象授予了 694.08 万股限制性股票。

通过向在职核心员工授予第二类限制性股票，有助于进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

4. 据公开新闻，概伦电子进入上海硬核科技企业 TOP100 榜单，请展开介绍。

答：3 月 25 日，上海召开产业技术创新大会，正式发布《2023 上海硬核科技企业 TOP100 榜单》。作为国内首家 EDA 上市公司，概伦电子凭借十余年长期专注技术创新，关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业的行业地位，荣登榜单，也进一步展现了 EDA 作为流程和设计方法学载体的重要战略价值。

该榜单评价涉及 1500 余家企业，涵盖上海市国家级和市级企业技术中心、上市公司、新兴产业百强企业、民营制造业百强企业以及承担市级重大项目的企业等。

硬核科技是高科技中的前沿技术，直接引领着高科技产业尤其是战略性新兴产业发展的方向和形态，也是未来产业发展的航向标。概伦电子一直致力于联动芯片设计与制造，打造应用驱动的 EDA 全流程。未来也将携手更多合作伙伴，合力建设基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈，共同推动中国集成电路行业的发展。

5. 近日，概伦电子作为命题企业参与了中国研究生创“芯”大赛，请详细介绍下参与背景？

答：中国研究生创“芯”大赛是中国研究生创新实践系列赛事之一，由教育部学位管理与研究生教育司指导，中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心主办，华中科技大学承办，清华海峡研究院作为秘书处。大赛面向国内外研究生及取得研究生入学资格的大四本科生。2023 年第六届大赛设有集成电路设计、半导体器件与工艺、光电子芯片与器件、EDA 算法与工具设计四大方向。

作为大赛的命题企业之一，概伦电子对外公布了三道企业命题，内容涵盖模拟射频和器件建模方向。公司秉持与中国集成电路行业共同成长的信念，始终致力于为中国集成电路产业打造多层次的专业人才培养机制，积极参与产教协同项目，全力支持第六届中国研究生创“芯”大赛。

6. 公司在产学研合作方面的具体措施和进展？

答：公司一直积极加强与国内外各大高校的技术交流并积极探索多方位的产学研合作，比如：（1）2020 年 9 月，公司与山东大学共同主办“山东大学-概伦电子集成电路研究生 EDA 创新班”，每年可以联合培养 20-30 名 EDA 专业的研究生，为 EDA 人才的实习实训、就业培养、创新创业等多方面提供支持，实现系统化的产学研深度合作；（2）2022 年 2 月，公司与北京大学集成电路学院及上海交通大学电子信息与电气工程学院相关团队联合研发的新一代高精度快速波形发生与测量套件 FS-Pro HP-FWGMK 正

式发布,填补了其半导体参数测试系统 FS-Pro 在短脉冲测试(PIV)的空缺,是又一国内产学研深度合作的典范;(3)2022年3月,公司与北大资产经营有限公司等合作方共同出资设立合资公司-上海伦刻电子有限公司,该合资公司的业务方向主要为研发自主知识产权的高精度源测试单元(SMU)和短脉冲测试模组(PIV)及适配的测量算法和测量软件,并集成为通用或专用的半导体参数测试系统。公司将依托该合资公司与北京大学及其相关技术团队开展深入合作,充分利用北京大学的优质技术资源和公司现有产品的技术积淀,进一步提升公司半导体参数测试产品的技术水平和市场竞争力,推动研发成果的商业化;(4)2022年4月,公司与北京大学签署合作协议,双方共建 EDA 创新联合实验室,结合双方的产业优势与科研实力,促进 EDA 技术创新发展和推动国产 EDA 全流程解决方案的建设和推广,培养更多高精尖的产业人才;(5)公司积极参与及支持上海集成电路紧缺人才培养项目,多位研发技术人员受邀特聘为培训讲师,在上海大学等高校开设集成电路设计与器件基础及 EDA 相关课程;(6)公司连续多年支持 EDA 设计精英挑战赛等集成电路和 EDA 细分领域专业赛事,积极参与产教协同项目,以出题、交流、指导等一系列形式帮助参赛高校学生完成挑战。

未来,公司会持续与国内外高校进行多种形式及渠道的沟通交流,不断创新 EDA 人才联合培养模式,实现全方位的产学研合作。

7. 公司如何看待 AI (人工智能) 技术发展对 EDA 行业的推动作用?

答: EDA 和 AI 技术的结合在改善芯片 PPA 性能、提升设计环节生产效率和系统级优化等方面拥有广阔的发展空间,EDA 领域学术界、产业界都已注意到 AI 对 EDA 产业变革的巨大驱动力,AI 辅助 EDA 已经成为业界共识和不可阻挡的趋势,公司也将密

	<p>切关注人工智能等与 EDA 领域相关的前沿技术的发展。</p> <p>作为国内首家 EDA 上市公司,概伦电子是一家关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业。公司总体发展战略为围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局,面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求,为客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 产品。同时,通过 EDA 生态建设,持续致力于倡导和推动行业的协同发展,联动设计与制造,并联合主要的领先集成电路企业及 EDA 生态合作伙伴,打造行业领先的应用驱动的 EDA 全流程解决方案。</p>
日期	2023 年 3 月 31 日